

- (a) either the manufacturer alone or the manufacturer in concert with the user of the integrated circuit originated the design or program;
- (b) the program is unalterably fixed at the time of manufacture; and
- (c) the manufacturer establishes that the design, basic functions and performance of the integrated circuit are only for the intended end-use.

(3) Assemblies of electronic components, modules, printed circuit boards with mounted components, substrates and integrated circuits, including packages therefor, as follows:

- (a) substrates for printed circuits, including ceramic and coated metal substrates, single-sided, double-sided or multilayer, and thin copper foils therefor, other than

- (i) printed circuit boards that are manufactured from

- (A) paper-base phenolics,
- (B) glass-cloth melamine,
- (C) glass epoxy resin, uncoated or coated with copper foil of a thickness of 18  $\mu\text{m}$  or greater,

- (D) polyethylene terephthalate, or

- (E) any other insulating material that has

- (I) a maximum continuous rated operating temperature not above 150°C,
- (II) a dissipation factor equal to or greater than 0.009 at 1 MHz,
- (III) a relative dielectric constant equal to or less than 8 at 1 MHz, and
- (IV) a coefficient of expansion equal to or greater than  $\pm 10^{-5}/^{\circ}\text{C}$  over a temperature range of 0°C to 120°C,

- (ii) ceramic substrates that have not more than two layers of interconnections, including the ground plane, or

- (iii) copper foil that has a thickness of 18  $\mu\text{m}$  or greater;

(b) ceramic packages for integrated circuits that are designed for hermetically sealed pin or pad grid-array, leadless carrier or surface-mounted configurations, other than those that

- (i) are of a single-in-line, dual-in-line or flat-pack configuration,
- (ii) have pin, pad or lead spacings of 2.5 mm or more, and

- (iii) have 40 leads or fewer;

(c) assemblies, modules and printed circuit boards with mounted components that contain

- (i) substrates for printed circuit boards that are included in paragraph (a), or
- (ii) components that are included in this List, other than

(A) those in which the only components included in this List are capacitors,

(B) power-supply assemblies,

(C) non-coherent light-emitting alphanumeric displays that incorporate monolithic integrated circuits and that

- a) leur conception ou leurs programmes sont effectués par leur fabricant seul ou en collaboration avec leur utilisateur;
- b) ils ont des programmes emmagasinés de façon inaltérable au moment de leur fabrication;
- c) leur fabricant établit que leur conception, leurs fonctions de base et leurs performances répondent uniquement à l'utilisation finale prévue.

(3) Ensembles de composants électroniques, modules, plaques de circuits imprimés avec composants incorporés, substrats et circuits intégrés, y compris leurs boîtiers, à savoir:

- a) substrats pour plaques de circuits imprimés, notamment substrats céramiques et de métal revêtu, simple face, double face ou multicouches, et feuilles de cuivre minces pour ces substrats, à l'exclusion:

- (i) des plaques de circuits imprimés fabriquées à partir de l'un des matériaux ci-après:

- (A) papier bakéliné,
- (B) tissu de verre mélamine,
- (C) tissu de verre à base de résine époxyde non revêtu ou revêtu d'une feuille de cuivre d'une épaisseur d'au moins 18  $\mu\text{m}$ ,

- (D) téréphtalate de polyéthylène,

- (E) tout autre matériau isolant qui a, à la fois:

- (I) une température maximale nominale d'utilisation permanente d'au plus 150 °C,
- (II) un facteur de dissipation à 1 MHz d'au moins 0,009,
- (III) une constante diélectrique relative à 1 MHz d'au plus 8,
- (IV) un coefficient d'expansion d'au moins  $\pm 10^{-5}$  par °C (degré centigrade) dans une gamme de températures de 0 °C à 120 °C,

- (ii) des substrats céramiques ne comportant pas plus de deux couches d'interconnexions, y compris le plan de masse,

- (iii) des feuilles de cuivre d'une épaisseur d'au moins 18  $\mu\text{m}$ ;

b) boîtiers céramiques de circuits intégrés conçus pour des configurations à réseau en grille de broches ou de plots, à support sans sortie ou à montage de surface, hermétiquement scellés, à l'exclusion de ceux qui ont à la fois:

- (i) une configuration à sorties sur une ligne, sur deux lignes ou en boîtier plat,

- (ii) un espacement des broches, des plots ou des fils d'au moins 2,5 mm,

- (iii) une composition d'au plus 40 fils;

c) ensembles, modules et plaques de circuits imprimés avec composants incorporés qui:

- (i) soit comportent des substrats de plaques de circuits imprimés inclus dans l'alinéa a),

- (ii) soit contiennent des composants inclus dans la présente liste, à l'exclusion de ce qui suit:

(A) ensembles, modules et plaques de circuits imprimés dont les seuls composants inclus dans la présente liste sont des condensateurs,

(B) ensembles d'alimentation,

(C) visuels alphanumériques émettant de la lumière non cohérente et comprenant des circuits intégrés monolithiques qui à la fois: